



# ПАСПОРТ

МИКРОСХЕМА КИТР721

соответствует техническим условиям 0.348.143 ТУ

1. Функциональное назначение: микросхема представляет собой двухступенчатый триггер с раздельными входами. При соединении выхода 10 со входом 2, а выхода 6 со входом 13 (см. принципиальную электрическую схему) может работать как триггер со счетным входом.

2. Режим работы:

- напряжение питания постоянного тока (Бпит) минус 27 В;
- мощность, потребляемая от источника питания, (Р), 80 мВт.

3. Основные электрические параметры указаны в таблице.

Наименование параметра	Величина параметра		Наименование параметра	Величина параметра	
	не менее	не более		не менее	не более
Напряжение на входе микросхемы, соответствующее "лог.0" ( $U_{вх}$ ), В	-	минус 2,0	Нагрузочная способность $N$ , мк	-	15
Напряжение на входе микросхемы, соответствующее "лог.1" ( $U_{вх}$ ), В	минус 8,5	минус 20,0	Помехоустойчивость, $U_{лом. макс.}$ , В	1,0	-
Выходное напряжение в состоянии "лог.0" ( $U_{вых}$ ), В	-	минус 1,0	Входное сопротивление, $R_{вх}$ , кОм.	15,0	-
Выходное напряжение в состоянии "лог.1" ( $U_{вых}$ ), В	минус 9,5	минус 20	Среднее время задержки распространения информации при $C_H=100$ пФ, $R_H=1$ кОм, $t_{зр.}$ мкс.	-	1,2

4. Содержание золота - 0,00794 г.

5. Рекомендации по установке микросхемы:

5.1. Микросхемы устанавливают на плате с зазором не менее 1,2 мм с последующей прыжковкой и приклейкой kleem.

5.2. Пайку выводов рекомендуется производить:

- при лужении методом погружения в расплавленный припой:  
температура расплавленного припоя, °С, не более . . . . . 250  
время погружения, с., не более . . . . . 2  
расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода), мм, не более . . . . . 1,2  
допустимое количество погружений, не более . . . . . 2  
интервал между двумя погружениями, мин., не более . . . . . 5  
Припой ПОССу-61-0,5 ГОСТ 1499-70 и флюс ОКСи по нормали №.054.063;
- одножальным паяльником:  
температура жала паяльника, °С, не более . . . . . 280  
время касания каждого вывода, с., не более . . . . . 3  
расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм, не менее . . . . . 1,2  
интервал между пайками соседних выводов, с., не менее . . . . . 10  
жало паяльника должно быть заземлено;
- групповым паяльником:  
температура жала группового паяльника, °С, не более . . . . . 265  
время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы), с., не более . . . . . 3  
расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм, не менее . . . . . 1,2  
интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы, мин., не менее . . . . . 5  
жало группового паяльника должно быть заземлено.

5.3. Микросхему допускается использовать в аппаратуре после 2-кратного демонтажа.

5.4. Все не используемые при эксплуатации входы микросхемы должны быть заземлены.

5.5. В случае ремонта аппаратуры микросхему заменять только при отключенных источниках питания.

5.6. Выводы плат с микросхемами во время распайки, лакировки, хранения и транспортировки должны быть закорочены и по возможности заземлены.

5.7. Необходимо предохранять микросхему от воздействия статических зарядов, вызывающих напряжение между любыми выводами микросхемы, более 30 В.

5.8. После монтажа микросхемы должны быть защищены в соответствии с ОСТ II НО.014.001. Температура сушки лака не более +60 °С.

6. Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С . . . . . от минус 10 до +70
- относительная влажность воздуха при температуре +25°C, %, не более . . . . . 98
- вибрация в диапазоне частот от 1 до 600 Гц с ускорением,  $\mathcal{Z}$ , не более . . . . . 10
- многократные удары с ускорением,  $\mathcal{Z}$ , не более . . . . . 75
- линейные (центрробежные) ускорения,  $\mathcal{Z}$ , не более . . . . . 25

7. Время гарантийной наработки 10 000 ч.

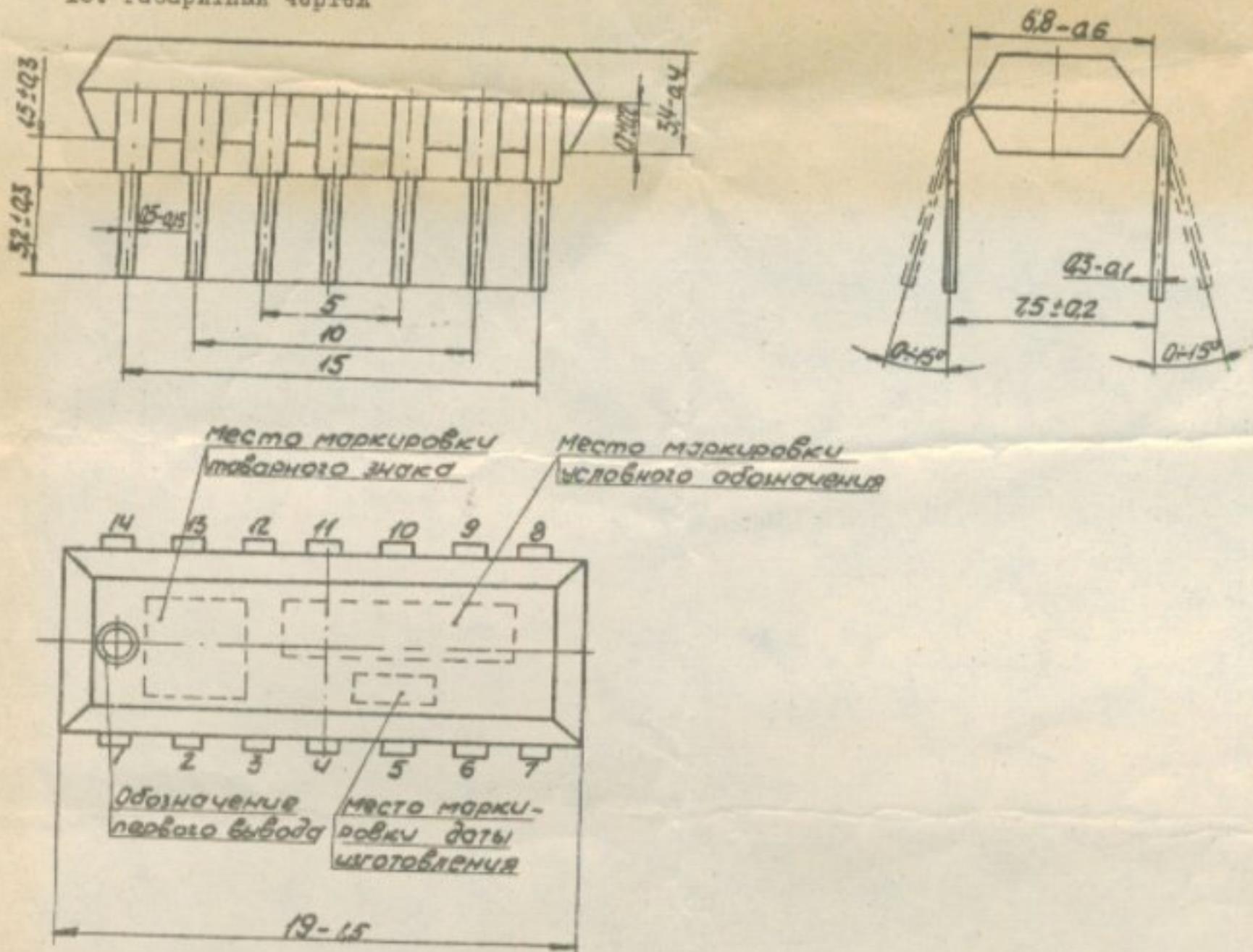
8. Срок хранения 5 лет.

9. Гарантии предприятия-изготовителя.

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие всех поставляемых микросхем требованиям общих и частных технических условий и производит безвозмездную поставку новых микросхем или возмещает стоимость микросхем (согласно действующим прейскурантам), если в течение установленного срока хранения или времени гарантийной наработки будет установлено, что микросхемы не удовлетворяют соответствующим требованиям общих и частных технических условий при соблюдении потребителем режимов эксплуатации и правил хранения, а также указаний и рекомендаций по применению и эксплуатации микросхем. Кроме того, поставщик несет материальную ответственность путем уплаты штрафа в размере 15% стоимости этих микросхем и возмещения транспортных расходов по их пересылке.

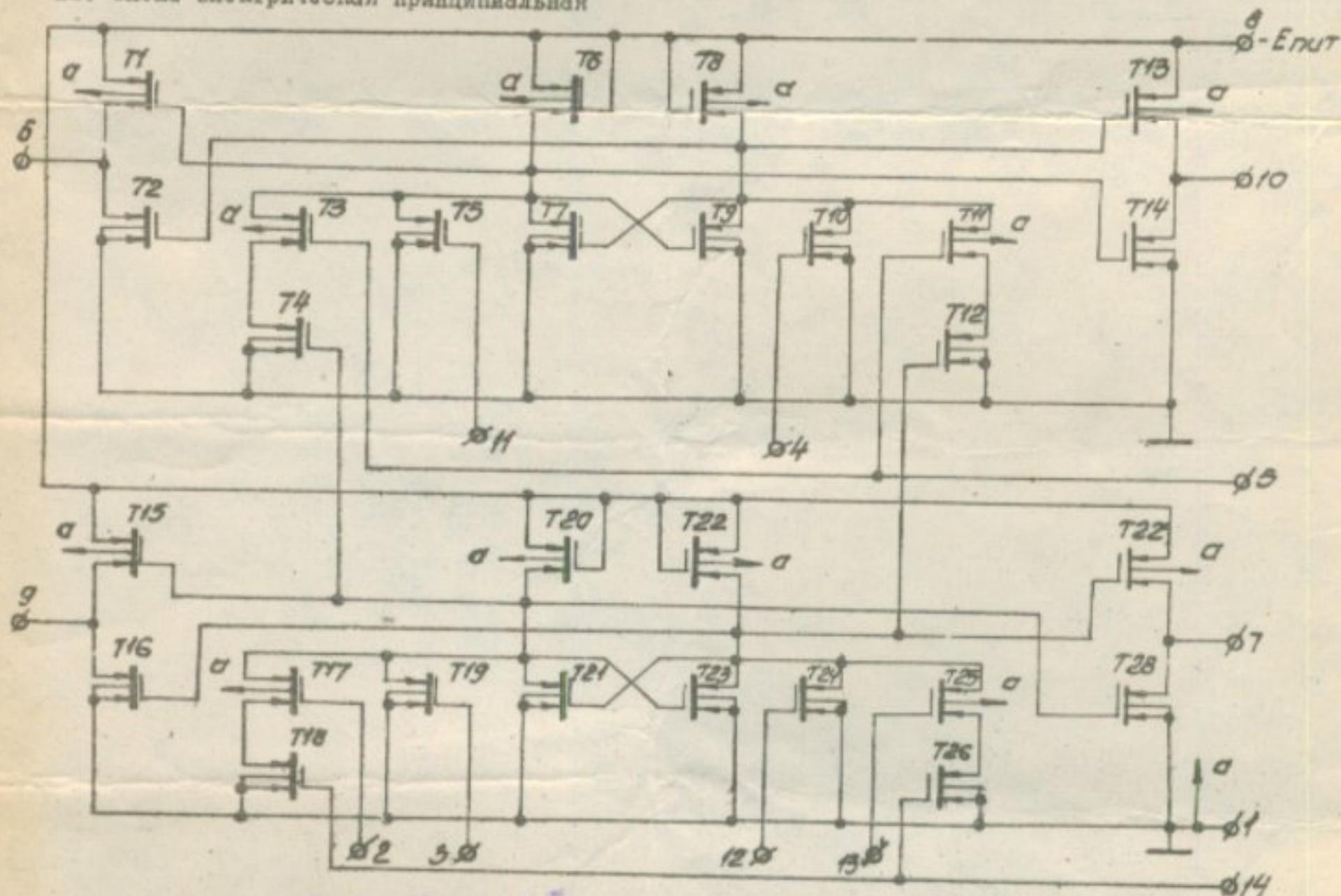
9.2. Гарантии исчисляются со дня приемки микросхем ОТК.

#### 10. Габаритный чертеж



II. Масса микросхемы не более 1.1 г.

#### 12. Схема электрическая принципиальная



**В. Дата выпуска**

234 - 75

Штамп ОТК

